

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6101xxxxMR-G
標準質量: 16 mg

| 名称 | 質量(mg) | 物質名称 | 構成比率(ppm) | CAS No. |
|-----------|--------|---------|-----------|------------|
| シリコンチップ | 0.454 | シリコン | 28400 | 7440-21-3 |
| | | - 珪素 | <1 | 7440-38-2 |
| リードフレーム | 5.503 | 銅 | 343900 | 7440-50-8 |
| | | 錫 | 1400 | 7440-31-5 |
| | | 亜鉛 | 1300 | 7440-66-6 |
| | | クロム | 1500 | 7440-47-3 |
| | | 銀 | 20300 | 7440-22-4 |
| | | | | |
| ダイアタッチ | 0.049 | 銀 | 3100 | 7440-22-4 |
| | | エポキシ | 600 | — |
| ボンディングワイヤ | 0.050 | 金 | 3100 | 7440-57-5 |
| | | | | |
| 封止樹脂 | 7.472 | 溶融シリカ | 467000 | 60676-86-0 |
| | | エポキシ樹脂 | 44400 | — |
| | | フェノール樹脂 | 37300 | — |
| | | 金属水酸化物 | 26600 | — |
| 端子メッキ | 0.340 | 錫 | 21300 | 7440-31-5 |
| | | | | |

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。